

证券代码：300623

证券简称：捷捷微电

公告编号：2026-002

江苏捷捷微电子股份有限公司 2025 年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。

非标准审计意见提示

适用 不适用

公司上市时未盈利且目前未实现盈利

适用 不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

适用 不适用

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 832,079,919.00 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.50 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

适用 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	捷捷微电	股票代码	300623
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	张家铨	沈志鹏	
办公地址	江苏省启东市经济开发区 钱塘江路 3000 号	江苏省启东市经济开发区 钱塘江路 3000 号	
传真	0513-83220081	0513-83220081	
电话	0513-83228813	0513-83228813	
电子信箱	jj@jjwdz.com	jj@jjwdz.com	

2、报告期主要业务或产品简介

根据《国民经济行业分类与代码》（GB/T4754-2017）公司所处行业为计算机、通信和其他电子设备制造业（C39）和电气机械和器材制造业（C38），属于《产业结构调整指导目录》鼓励类范畴，同时，隶属于国家鼓励的战略性新兴产业范畴。

公司专业从事功率半导体芯片和器件的研发、设计、生产和销售，具备以先进的芯片技术和封装设计、制程及测试为核心竞争力的业务体系，业务模式以 IDM 模式为主。公司

是集功率半导体器件、功率集成电路、新型元件的芯片研发和制造、器件研发和封测、芯片及器件销售和服务为一体的功率（电力）半导体器件制造商和品牌运营商。公司主营产品为各类电力电子器件和芯片，分别为：晶闸管器件和芯片、防护类器件和芯片（包括：TVS、放电管、ESD、集成放电管、贴片 Y 电容、压敏电阻等）、二极管器件和芯片（包括：整流二极管、快恢复二极管、肖特基二极管等）、晶体管器件和芯片、MOSFET 器件和芯片、IGBT 器件、光耦、模块及组件、碳化硅器件等。

公司所处的行业是功率半导体分立器件行业，分立器件是电力电子产品的基础之一，也是构成电力电子变化装置的核心器件之一，主要用于电力电子设备的变频、变相、变压、逆变、整流、稳压、开关、增幅、保护等，具有应用范围广、用量大等特点，在消费电子、汽车电子、电子仪器仪表、工业及自动控制、计算机及周边设备、网络通讯、智能穿戴、智能监控、光伏、物联网等众多国民经济领域均有广泛的应用。

公司通过了 IATF16949 汽车行业质量体系认证、ISO9001 质量体系认证、ISO14001 环境体系认证、ISO45001 职业健康体系认证、QC080000 有害物质过程管理体系认证、UL 安全认证、SGS 环保标准鉴定认证、知识产权管理体系认证、两化融合管理体系等规定，公司产品应符合 UL 电气绝缘性要求、RoHS 环保要求、REACH 化学品注册、评估、许可和限制要求、无卤化等。

一、目前公司主要经营模式：

公司晶闸管系列产品、二极管及防护系列产品采用垂直整合（IDM）一体化的经营模式，即集功率半导体芯片设计、制造、器件设计、封装、测试、终端销售与服务等纵向产业链为一体。公司 MOSFET 及 IGBT 系列产品采用垂直整合（IDM）一体化的经营模式和少部分产品的委外流片相结合的业务模式，目前，部分芯片为委外流片，部分器件封测代工。

目前，公司具体经营模式如下：

1、采购模式

公司物资管理部负责原材料、辅助生产材料的采购，具体采购程序如下：

- （1）根据采购计划对采购产品进行分类
- （2）采购信息的编制和确定

物资管理部根据《采购计划单》编制《采购合同》，主要原材料采购文件应包括拟采购产品必要的信息。如有必要，物资采购部应请相关技术、品质管理部参与采购要求和规范的制定，或与供方共同制定采购要求和规范，以便利用供方专业知识使公司获益。

（3）采购的执行

物资管理部根据经批准的《采购合同》，在《合格供方名录》的供方范围内进行采购。采购通常以与供方签订供货合同的方式进行，以明确采购产品的价格、交货期限、技术标准、验收条件、质量要求、违约责任等相关内容；对于长年供货的供方，物资管理部在以合同的方式向供方明确采购产品的技术标准、验收条件、质量要求、违约责任等相关内容后，可以采用传真购货或口头通知的方式进行具体的采购；物资管理部应及时跟踪采购进度，反馈给相关部门。

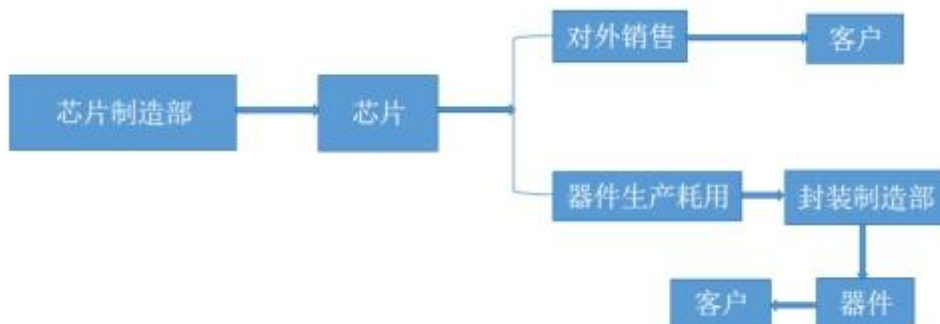
（4）采购产品的验证

物资管理部应协调采购产品的验证活动；当公司或公司客户提出在供方的现场实施验证时，物资管理部应在采购信息中对需要在供应商现场开展验证的安排作出规定；采购产品到达公司后，材料仓库进行登记并存放于待检区，报相关技术、品质管理部进行检验；与供应商签订的技术协议应交品质管理部进行审核，品质管理部负责技术协议文件的管理和发放，确保公司使用的技术协议是现行有效的。

2、生产模式

(1) 晶闸管和防护器件

公司根据销售订单要求，制定生产计划，由技术管理部制定工艺卡、作业指导书和检验规程，交给生产人员在生产中参照执行。公司生产部门分为芯片制造部和封装制造部，生产模式如下：



①生产计划和任务单

芯片制造部/封装制造部根据产品要求评审的结果，考虑库存情况，并结合公司的生产能力，制定《生产计划单》；芯片制造部/封装制造部根据《生产计划单》，组织下达《随工单》安排生产；

②动力设备部负责按《设备管理控制程序》的规定做好生产设备的管理、维护和保养工作。

③生产过程控制

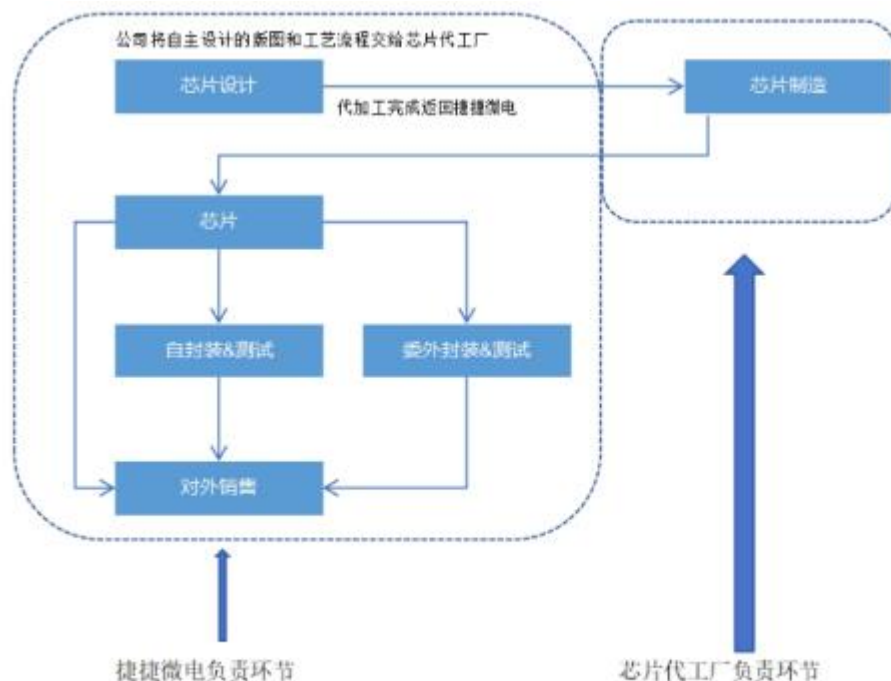
A. 技术管理部负责编制适宜让生产员工清楚理解的工艺卡、作业指导书和检验规程；

B. 芯片制造部/封装制造部组织和监督操作者严格依据文件的要求进行操作，做好自检和互检要求的记录；

C. 品质管理部根据《产品的监视和测量控制程序》的要求进行产品检验，按《纠正措施控制程序》和《预防措施控制程序》的要求对异常现象进行整改和预防。

(2) MOSFET

公司 MOSFET 采用垂直整合（IDM）一体化的经营模式和部分产品的委外流片相结合的业务模式。公司部分产品的芯片委托芯片代工厂进行芯片制造，由于产能紧张及发挥产业内的协同创新作用，芯片一部分用于公司自主封装，另一部分委托外部封测厂进行封测。除部分产品的芯片制造由代工厂代工生产外，公司 MOSFET 产品与晶闸管和防护器件产品生产模式一致。以下为部分芯片委外流片的模式图：



标准按照质量部编制规范检验。

①工程部门在线 WIP 跟踪，运营部负责协助处理。

②封测委外

A. 运营部接到销售或者工程部门计划后，经过运营负责人审批后，制定封装计划下发供应商。

B. 物资管理部根据运营订单，安排对应的芯片发货。

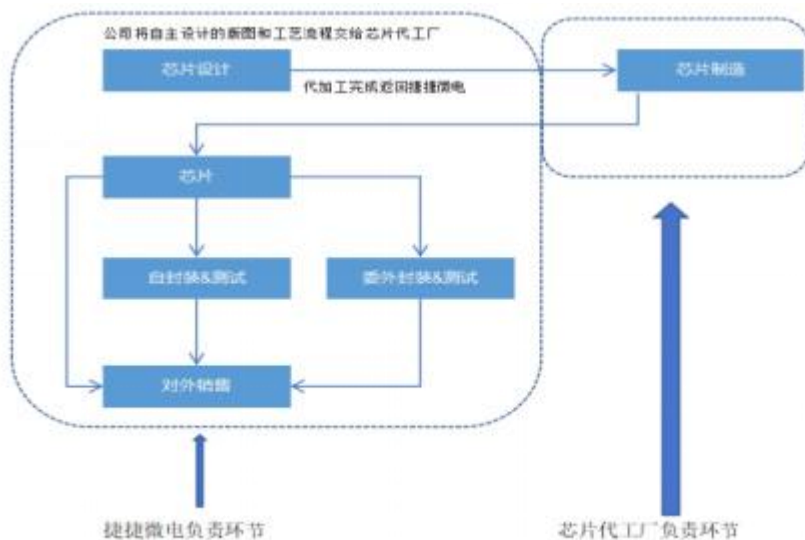
C. 供应商按照订单进行加工，产出后供应商需要以邮件形式给出正式出货邮件，出货邮件需要包含型号、数量、订单号，同时及时上传数据到 FTP。

D. 运营部负责产品收货，根据封装厂商出货清单核实后发货。

E. 质量部根据检验规范进行入库检验，检验不合格由相关人员进行检验处理。

(3) IGBT

公司 IGBT 采用垂直整合（IDM）一体化的经营模式和部分产品的委外流片相结合的业务模式。公司部分产品的芯片委托芯片代工厂进行芯片制造，由于产能紧张及发挥产业内的协同创新作用，芯片一部分用于公司自主封装，另一部分委托外部封测厂进行封测（主要为消费领域类器件）。除部分产品的芯片制造由代工厂代工生产外，公司 IGBT 产品与晶闸管和防护器件产品生产模式一致。以下为部分芯片委外流片的模式图：



标准按照质量部编制规范检验。

①工程部门在线 WIP 跟踪，运营部负责协助处理。

②封测委外。

A. 运营部接到销售或者工程部门计划后，经过运营负责人审批后，制定封装计划下发供应商。

B. 物资管理部根据运营订单，安排对应的芯片发货。

C. 供应商按照订单进行加工，产出后供应商需要以邮件形式给出正式出货邮件，出货邮件需要包含型号，数量，订单号，同时及时上传数据到 FTP。

D. 运营部负责产品收货，根据封装厂商出货清单核实后发货。

E. 质量部根据检验规范进行入库检验，检验不合格时进行相应处理。

(4) 光电耦合器

公司光电耦合器采用分公司+总部垂直整合（IDM）一体化的经营模式相结合的业务模式。公司部分产品的接收芯片采购其他外部公司产品，所有 LED 芯片均采购其他公司产品，由于产能紧张及发挥产业内的协同创新作用，一部分产品委托外部封测厂进行封测。除部分产品的芯片采购其他公司产品外，公司光电耦合器产品与晶闸管和防护器件产品生产模式一致。

公司根据销售订单要求，制定生产计划，由光耦产品线技术部制定工艺卡、作业指导书和检验规程，交给生产人员在生产中参照执行。公司生产部门主要为封装制造部，生产模式如下：



①生产计划和任务单

生产计划部根据产品要求评审的结果，考虑库存情况，并结合公司的生产能力，制定《生产计划单》；封装制造部根据《生产计划单》，组织下达《随工单》安排生产；

②动力设备部负责按《设备管理控制程序》的规定做好生产设备的管理、维护和保养工作。

③生产过程控制

- A. 技术管理部负责编制适宜让生产员工清楚理解的工艺卡、作业指导书和检验规程；
- B. 封装制造部组织和监督操作者严格依据文件的要求进行操作，做好自检和互检要求的记录；
- C. 品质管理部根据《产品的监视和测量控制程序》的要求进行产品检验，按《纠正措施控制程序》和《预防措施控制程序》的要求对异常现象进行整改和预防。

(5) 模块

公司根据销售订单要求，制定生产计划，由技术部制定工艺卡、作业指导书和检验规程，生产部门按照标准进行生产作业，生产模式如下：



①生产计划

模块计划部根据产品要求评审的结果，考虑库存情况，并结合公司的生产能力，制定《生产计划单》；模块制造部根据《生产计划单》，组织下达《随工单》安排生产。

②模块设备科负责按《设备管理控制程序》的规定做好生产设备的管理、维护和保养工作。

③生产过程控制

- A. 技术管理部负责编制工艺卡、作业指导书和测试规范和检验规范；
- B. 模块制造部组织和监督操作者严格依据文件的要求进行操作，做好自检和互检要求的记录；
- C. 品质管理部根据《产品的监视和测量控制程序》的要求进行产品检验，按《纠正措施控制程序》和《预防措施控制程序》的要求对异常现象进行整改和预防。

3、研发模式

公司主要采用自主研发模式，公司设有工程技术研究中心，主导新技术、新产品的研究和开发。为提高研发人员的积极性，公司建立了鼓励发明创造的奖励制度。该奖励制度不仅提高了研发人员的工作积极性，还可以激励全体员工参与技术革新活动，取得了较为明显的成效。

公司研发活动按照以下流程开展：

(1) 项目来源

公司研发项目主要来源于以下三个方面：一是工程技术研究中心基于对行业发展趋势的深入调研并结合公司发展战略和发展目标，选择新技术、新工艺、新产品进行研发；二是公司市场部/销售部通过对市场需求进行综合调研后，对前景广阔且市场需求大的新产品、新技术、新工艺提出立项申请；三是来源于客户定制化产品的研发需求。

(2) 项目立项

工程技术研究中心接到新产品需求信息后对产品需求信息进行初步论证，如初步论证可行，则召开项目立项会议，确定项目研发内容和项目负责人并组建项目组，正式启动项目研发工作。

(3) 设计和开发

项目组根据设计和开发的相关要求，开展设计和开发工作。设计和开发完成后，将召开评审会议，对项目是否已经完成设计和开发工作并取得相应的研发成果予以评定。

(4) 反馈和纠正

项目组根据会议评审结果，对项目设计和开发方案予以进一步完善，并将修改和完善的内容及时反馈给工程技术研究中心主任。

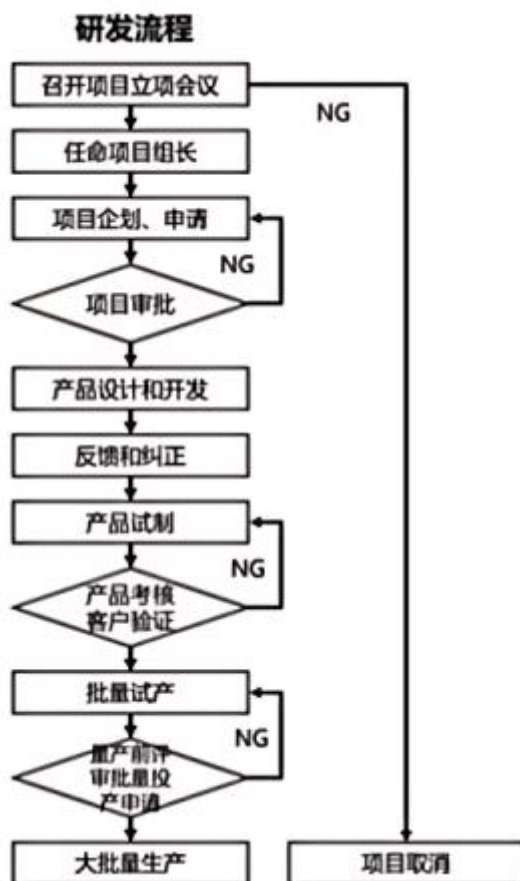
(5) 产品试制

项目组在品质、生产等相关部门的配合下，依据评审确定的设计和开发方案进行打

样，样品质量及性能由质量管理部负责检验和认定。如样品经检验并经客户验证合格，则召开项目评审会，对样品的性能参数予以全面评估，如评估认定样品的性能参数通过项目验收，则进入批量试生产阶段。

(6) 小批量试生产

产品试制通过后，进入小批量试生产环节。项目组指定具体研发人员全程跟踪小批量试生产的作业状况和产品品质，如小批量试生产产品符合相关要求，项目组提交批量投产申请，批量投产申请获得批准后，项目组将设计和开发成果移交生产部门进行大批量生产，项目研发工作结束。



4、销售模式

(1) 营销理念

公司的营销理念为：建立售前、售中、售后一体的市场营销团队，发展知名品牌客户和优质渠道商，与客户形成战略合作，树立公司国际品牌形象，提高市场占有率。

(2) 营销方式

公司产品应用的市场领域较多，产品规格多，且对产品性能要求各异。公司既销售公司通用规格的产品，也可以根据客户的诉求为其设计、生产定制化产品，并可对客户全方位的技术服务。具体销售流程如下：

A. 公司销售人员与客户进行初步沟通，了解客户的产品用途、需求、用量、付款条件等信息，及已有产品不足之处或预期产品需要达到的最佳效果，为客户提供选型服务或建议，与客户建立初步合作关系；

B. 如客户有特殊要求，销售人员应与应用工程师或其他部门工程师共同评估公司产品是否满足客户的要求，并选择合适的产品型号；

C. 销售人员和区域销售经理评估客户信誉状况，选择合作模式，后续按照此模式逐步

推进合作；

D. 销售人员提供给客户相应产品的规格书，向客户介绍公司产品特点、性能指标，帮助客户认识、了解公司的产品及性能，并听取客户进一步的意见；

E. 根据进度安排，销售人员准备好选型的样品提供给客户，及时跟进客户的试验情况，与客户沟通解决试验中遇到的问题，最终达到客户要求的理想效果；

F. 针对有特殊要求的客户，如其用量较大或其应用具有领域代表性，公司可为其设计、生产定制化产品，定制化产品销售流程如下：

a. 销售人员了解客户的产品特殊要求、产品应用领域、时间进度表、需求量、目标价格、付款条件等信息，填写《定制产品需求单》，交由区域经理或市场部、营销部正/副部长审核评估；

b. 市场营销部将《定制产品需求单》送交相关技术部门和质量中心，品质管理部组织各部门对定制产品的市场潜力、产品性能以及公司的生产能力、物料物资、资金情况进行评估，将评估结果向总经理汇报，由总经理做出最终批示；

c. 根据总经理同意生产定制产品的批示，市场营销部与客户签订定制产品加工合同；各部门按照分工开始生产样品，样品完成后，由相关技术部门完成产品的考核和试验；

d. 样品达到预期的性能指标后将该样品的试验结果和样品提供给客户进行产品试验，及时跟进客户的试验情况，改善产品性能并重新送样，最终满足客户要求的理想效果；

e. 根据客户定制产品的试验、生产情况，公司各部门对定制产品进行总结，确定是否将定制产品纳入公司标准产品的量产计划中。

5、质量管理模式

(1) 质量管理目标

根据 IATF16949 汽车行业质量体系认证、ISO9001 质量体系认证、ISO14001 环境体系认证、ISO45001 职业健康安全体系认证、QC080000 有害物质过程管理体系认证、UL 安全认证、SGS 环保标准鉴定认证、知识产权管理体系认证、两化融合管理体系等规定，公司产品应符合 UL 电气绝缘性要求、RoHS 环保要求、REACH 化学品注册、评估、许可和限制要求、无卤化等要求，明确各级人员的质量管理职责与权限，以保证公司质量体系持续有效运行，并最终获得顾客满意。

(2) 质量管理体系

由公司质量中心负责构建公司质量体系、有害物质减免管理体系、环境及职业健康安全管理体系相关的规章制度，确保公司产品质量符合品质标准、公司运营活动符合相关政策法规要求；同时，公司坚持持续改进及全员参与质量管理的理念，鼓励所有员工参与质量管理工作，建立 TQM 管理模式，通过 8D 方法、QCC 等活动体现全员参与和持续改进的质量管理模式，通过建立《数据分析与持续改进控制程序》、《纠正预防措施控制程序》、《QCC 活动管理办法》、《8D 控制程序》等程序来确保质量管理体系持续改进的要求。

(3) 质量过程控制

A. 满足顾客要求过程中的质量控制：确保顾客要求得到评审并传达到相关部门执行，顾客抱怨采用 8D 的方法并在客户要求的时间范围内提供相应改善报告，FA 实验室的建设满足顾客对失效品的原因分析从而制定有效地改善措施；

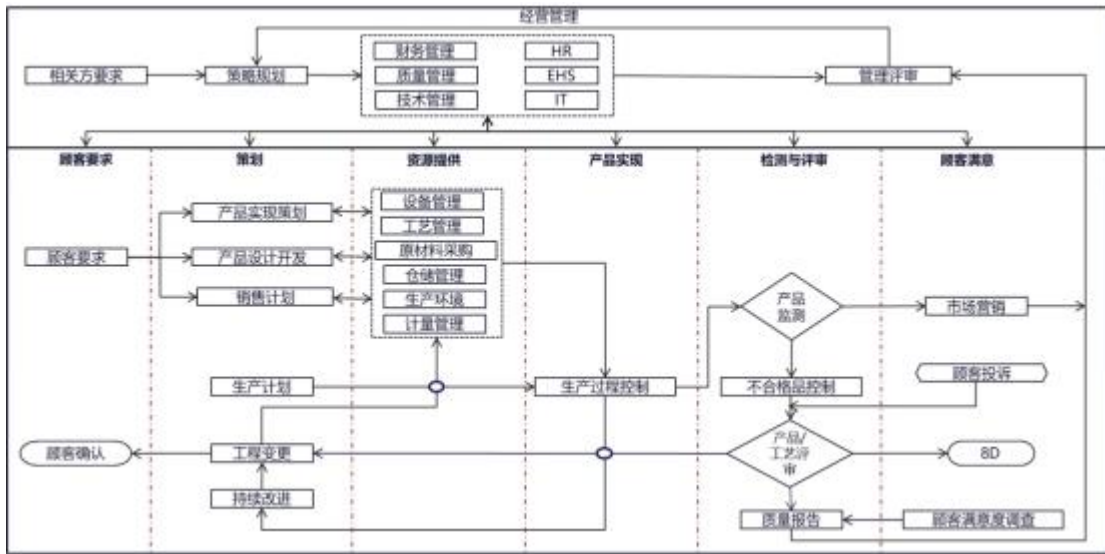
B. 研发过程质量控制：设定产品研发项目质量负责人，参与整个项目的质量管理，建立项目质量计划，确保研发过程中采用过程方法、FMEA/APQP/PPAP/MSA/SPC/DOE 等质量工具，其中 Fables+ 封测业务模式需要外协供应商参与整个研发过程尤其是产品的工艺研发由供应商负责开发，本公司研发人员确认；

C. 生产过程质量控制：在生产过程中都需要应用 CP/MSA/SPC/DOE 等质量工具，同时需要建立首末件检验，过程检验、入库及出库检验机制。IDM 模式在公司内部由本公司质

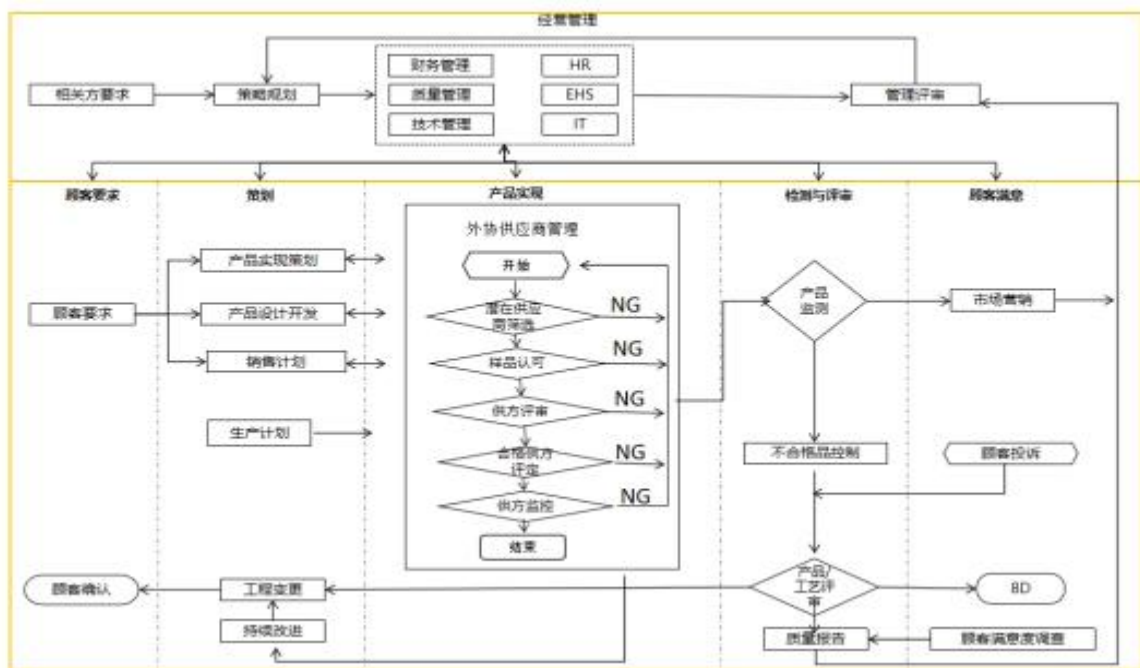
量中心直接监控或者执行，委外代工的业务模式由供应商质量部直接负责，公司对其从体系上进行保证，重点在于供应商的管理。公司成立独立的 SQE 部门从供应商的选择开始进行控制，通过使用 IATF16949/VDA6.3 等审核工具对其进行年度现场稽核，通过产品质量的月度、年度绩效考核来监控供应商的交付质量绩效，对其变更控制作为重点进行管控；

D. 管理过程质量控制：质量中心组织各公司进行交叉内审工作，对发现的问题进行改进，各公司取长补短共同发展，实现资源的共享和体系的一体化，最高管理者组织季度、年度管理评审根据评审结果制定公司战略、产品战略，通过问题改进确保质量管理体系持续的适宜性、充分性、有效性。

IDM 模式质量管理体系流程图：



委外代工业务质量管理体系流程图：



6、盈利模式

功率半导体芯片的设计制造能力是公司的核心竞争力，是公司可持续盈利及发展的基

础。公司多项功率半导体芯片和封装器件的先进技术不仅保证公司生产工艺领先、标准产品质量可靠，还能够按照客户提出的个性化需求设计、调整功率半导体芯片和封装器件的生产工艺，生产定制产品，及时满足终端产品在电能转换与控制、保护高端电子产品昂贵电路等方面的技术升级需求。同时，公司参与到客户的生产经营中，通过分析整理客户在产品结构调整、品质提升过程中的技术瓶颈，有针对性地研发新技术，改进生产工艺，并根据下游行业的发展趋势调整自身产品结构，经公司技术、市场、生产、财务、管理各部门共同严格论证后，将确定未来有广泛市场需求的定制产品转化为公司常规产品生产，最大程度地确保公司产品响应客户和行业发展的需要。

公司为客户定制产品不仅体现了公司研发创新的技术实力，也表现出公司与客户实现双赢的市场营销能力，因此，公司产品深受下游客户认可，品牌知名度和美誉度不断提升，客户结构正向大型化、国际化方向发展，同时，产品市场结构不断延伸，在保持传统家电市场、工业类市场优势地位的同时，正逐步进入航天、汽车电子、IT 产品等新兴市场。

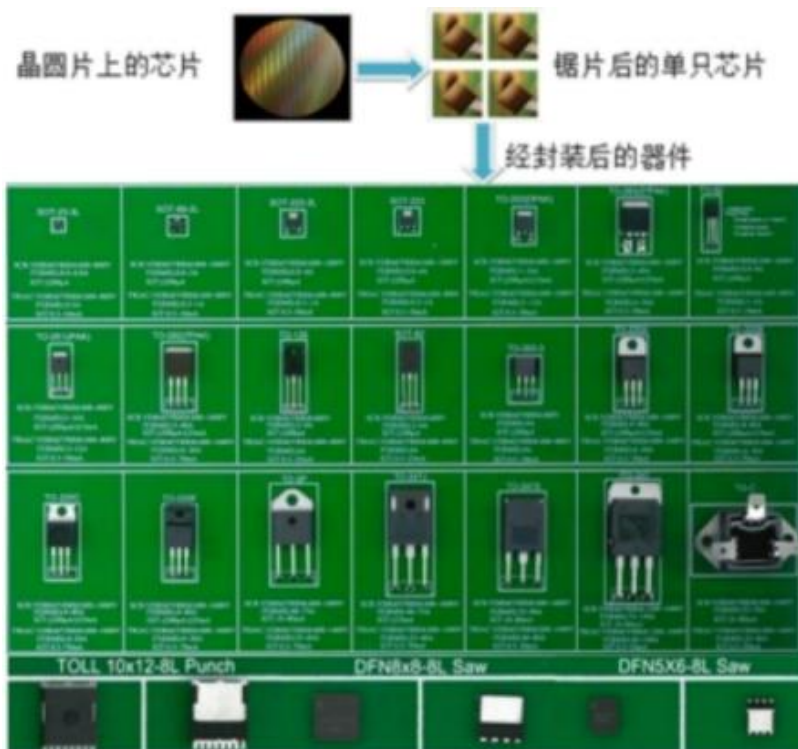
7、管理模式

在长期经营发展中，公司建立了符合公司自身经营特点和发展方式的管理模式，设置合理的职能部门，在公司董事会制定的经营路线下，坚持公开、透明地执行各项公司制度和计划，协调各部门之间有效配合，形成了较高的管理效率。

半导体行业是技术密集型行业，公司重视研发管理，根据公司现有和未来产品系列分别设立研发项目组，有针对性地研发新产品和新技术，最大程度地保证公司的研发效率和研发成果转化率，不断提高市场竞争力和盈利能力。同时，公司不断吸收引进先进人才，通过激励措施和实践培养，为公司未来发展储备技术、营销、采购等方面的管理人才。

二、公司主要产品系列及用途：

从产品构造划分，公司主要产品是功率半导体芯片和封装器件。功率半导体芯片是决定功率半导体分立器件性能的核心，在经过后道工序封装后，成为功率半导体分立器件成品。



1、晶闸管系列：

晶闸管（又称：可控硅）耐压高、电流大，主要用于电力变换与控制，可以用微小的信号功率对大功率的电流进行控制和变换，具有体积小、重量轻、耐压高、容量大、效率高、控制灵敏、使用寿命长等优点。晶闸管的功用不仅是整流，还可以用作无触点开关以快速接通或切断电流，实现将直流电变成交流电的逆变，将一种频率的交流电变成另一种频率的交流电等作用。晶闸管的出现，使半导体技术从弱电领域进入了强电领域，成为工业、交通运输、军事科研以至商业、民用电器等各方面广泛采用的电子元器件。

2、防护器件系列：

半导体防护器件种类较多，主要有半导体放电管（TSS）、瞬态抑制二极管（TVS）、静电防护元器件（ESD）、集成防护器件、Y 电容、压敏电阻等，可应用于仪器仪表、工业控制、汽车电子、手持终端设备、户外安防、电脑主机等各类需要防浪涌冲击、防静电的电子产品内部，保护内部昂贵的电子电路。由于使用场合广泛，市场需求量较大，半导体防护器件市场规模较为稳定。

3、二极管系列：

二极管是最常用的电子器件之一，二极管的单向导电特性可以把正弦波的交流电转变为脉动的直流电。用途广泛，几乎所有的电路中都有使用到。公司二极管芯片采用 SIPOS+GPP 钝化工艺，具有高可靠性，三种金属组合供客户选择，主要产品有高耐压整流二极管、快恢复二极管、肖特基二极管、整流二极管模块组件等，用于民用电器的电源整流、工业设备电源整流、漏电断路器、电表、通讯电源、变频器等应用领域。

4、MOSFET 系列：

MOSFET，金属-氧化物半导体场效应晶体管，一种全控制型半导体功率分立器件，通过栅极电压的变化来控制输出电流的大小，并实现开通和关断，输入阻抗大、导通电阻小、功耗低、漏电小、工作频率高，工艺基本成熟，是市场规模最大的功率分立器件。应用极其广泛，主要包括电源类和驱动控制类两大类应用。公司 MOSFET 系列产品主要包括中低压沟槽 MOSFET 产品、中低压分离栅 MOSFET 产品、中高压平面 VDMOS 产品以及超结 MOS 等产品，广泛用于消费电子、通信、工业控制、汽车电子等领域。

5、IGBT 系列：

IGBT，绝缘栅双极型晶体管，是由 BJT（双极结型晶体管）和 MOS（金属-氧化物场效应晶体管）组成的复合全控型-电压驱动式功率半导体器件，融合了 BJT 和 MOSFET 的两种器件的优点，BJT 饱和压降低及载流密度大，但驱动电流较大；MOSFET 驱动功率很小，开关速度快，但导通压降大，载流密度小。IGBT 综合了以上两种器件的优点，驱动功率小而饱和压降低，被称为是电力电子装置的“CPU”，高效节能减排的主力军。

6、碳化硅器件：

碳化硅肖特基二极管是碳化硅器件之一，具有超快的开关速度，超低的开关损耗，正向压降(Vf)为温度特性，易于并联，可承受更高耐压和更大的浪涌电流，用于电动汽车、消费类电子、新能源、轨道交通等领域，主要产品为塑封碳化硅肖特基二极管器件。

7、光电耦合器：

光电耦合器，简称光耦，英文 optical coupler，是由 LED 发射管芯片（简称 IR）+光电敏感接收芯片（简称 PT），或由 LED 发射管芯片（简称 IR）+光电敏感接收芯片（简称 PT）+功率可控硅（Power triac），或由 LED 发射管芯片（简称 IR）+光电敏感接收芯片（简称 PT）+MOS（金属-氧化物场效应晶体管）组成的复合型光电隔离器件，具有低电压-高电压隔离、信号隔离以消除初级干扰信号等优点，可以承受高达 8000V 的隔离电压，广泛应用于风光储、通讯、汽车、逆变器、家电、电源等行业。

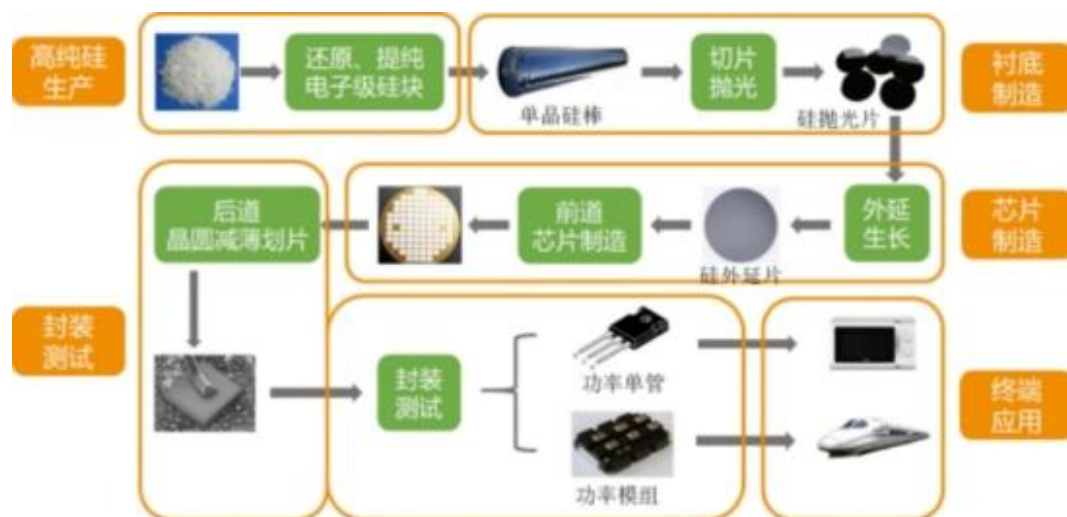
8、模块：

模块系列产品采用模块集成封装，把 SCR、Diodes、MOSFET、IGBT、FRD、SBD 等芯片组合成不同的电路拓扑结构；在模块基础上集成控制线路，衍生出了固态继电器、智能模块及 IPM 等功能模块，主要应用于调温系统、调光系统、调速等系统；产品应用覆盖工业传动、新能源发电、储能、特种电源等全场景。

9、其他：

功率型开关晶体管及达林顿晶体管，应用于点火器、磁电机等领域，具有良好的可靠性和质量。

功率分立器件：从石英砂到终端产品：



公司主要产品类别图示：

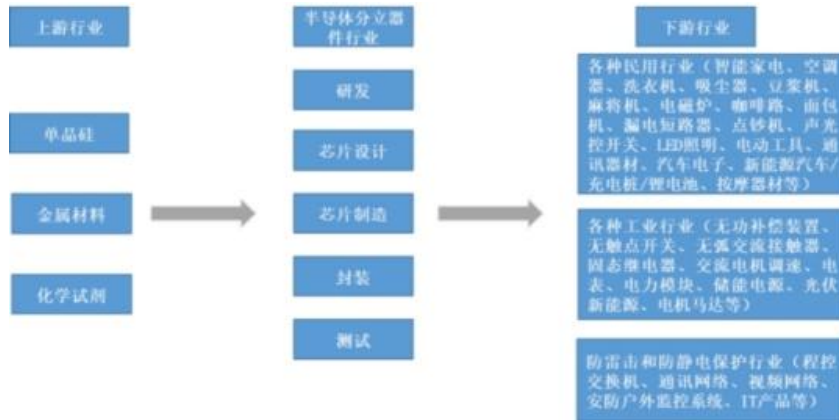


三、上下游行业及发展情况

1、与上下游行业间的关系：

公司所处半导体分立器件制造业的上游行业主要为单晶硅、金属材料、化学试剂行业，下游行业主要为家用电器、漏电断路器等民用领域，无功补偿装置、电力模块等工业领域，及通讯网络、IT 产品等的防雷击和防静电保护领域。由于电力电子技术的广泛渗透

性，在绝大多数的用电场合，都可能应用电力电子技术进行电能控制和优化。



2、上下游行业的发展情况

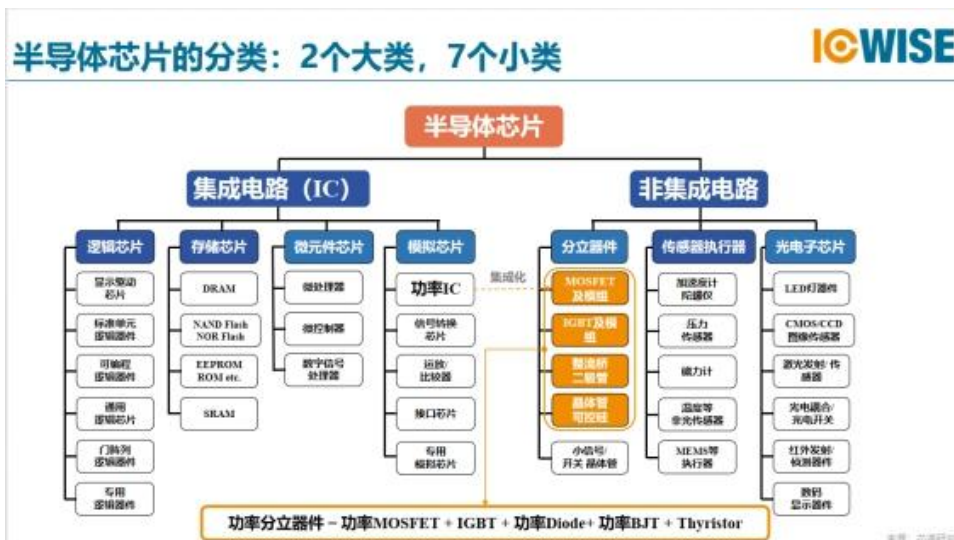
①上游行业

上游行业单晶硅的价格对半导体分立器件制造行业的生产成本有直接影响。目前单晶硅片市场趋于饱和，供需基本平衡；引线框架等金属材料和硼源等化学试剂的市场供应充足，价格比较稳定。

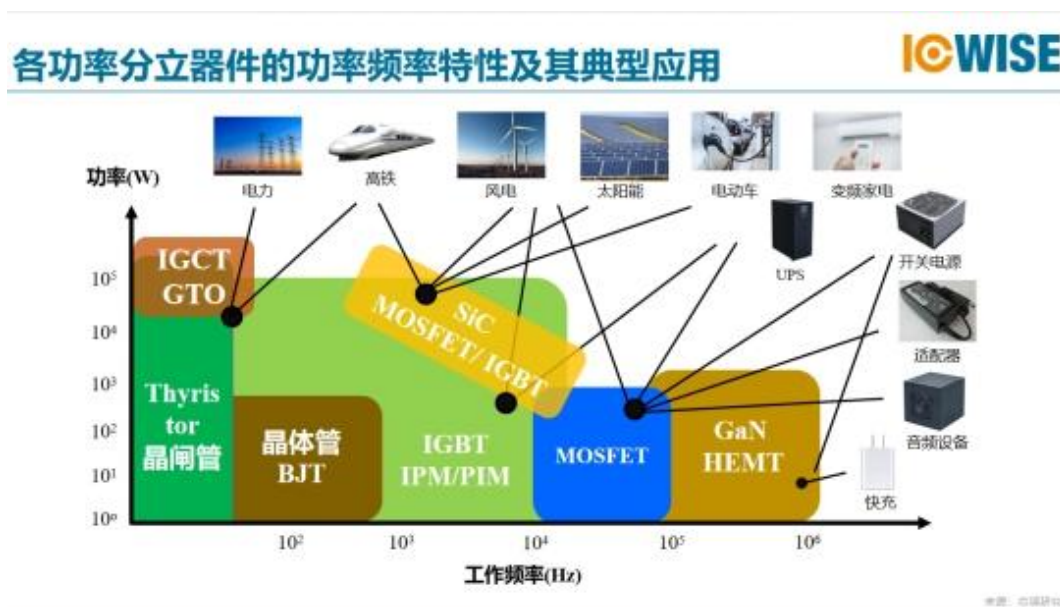
②下游行业

功率半导体分立器件的下游行业分布面极为广阔，终端产品的更新换代及科技进步引导的新产品面世，都为功率半导体分立器件带来不断增长的市场空间。功率半导体分立器件是连接弱电和强电的桥梁，无处不在，为了合理高效地利用电能，现在发达国家电能的75%需要经过功率半导体分立器件变换或控制后使用。目前我国经过变换或控制后使用的电能仅占30%，70%电能仍采用传统的传输方式，远远达不到应用电力电子技术才能实现的效果。随着我国在民用和工业各个领域对能源节约政策的深入落实，新技术、新工艺、新产品将陆续被研发和推广应用，满足市场需求的扩展和转变。

半导体芯片的分类：2 个大类，7 个小类：



半导体各功率分立器件的特性及其应用：



资料来源：芯谋研究

3、主要会计数据和财务指标

(1) 近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

元

	2025 年末	2024 年末	本年末比上年末增减	2023 年末
总资产	8,257,946,298.77	8,051,941,895.96	2.56%	7,721,873,336.43
归属于上市公司股东的净资产	6,031,310,372.71	5,810,732,305.93	3.80%	3,758,525,074.69
	2025 年	2024 年	本年比上年增减	2023 年
营业收入	3,494,134,538.24	2,844,685,043.17	22.83%	2,106,360,178.68
归属于上市公司股东的净利润	476,689,147.89	473,038,235.82	0.77%	219,129,187.55
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	476,476,304.47	415,729,550.26	14.61%	204,261,573.12
经营活动产生的现金流量净额	773,502,841.62	719,940,537.36	7.44%	934,614,802.10
基本每股收益（元/股）	0.57	0.63	-9.52%	0.30
稀释每股收益（元/股）	0.57	0.60	-5.00%	0.28
加权平均净资产收益率	8.10%	11.33%	-3.23%	5.97%

(2) 分季度主要会计数据

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	699,917,825.51	900,559,167.33	901,067,391.62	992,590,153.78
归属于上市公司股东的净利润	111,762,739.89	135,080,397.02	100,076,330.89	129,769,680.09
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	109,613,031.98	135,895,176.55	100,330,227.28	130,637,868.66
经营活动产生的现金流量净额	143,104,422.61	310,196,143.05	135,284,655.93	184,917,620.03

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 否

4、股本及股东情况

(1) 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	89,416	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	78,112	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0	持有特别表决权股份的股东总数（如有）	0
前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）									
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况				
					股份状态	数量			
江苏捷捷投资有限公司	境内非国有法人	24.66%	205,200,000.00	0.00	不适用				0.00
黄善兵	境内自然人	7.44%	61,929,424.00	46,447,068.00	不适用				0.00
南通中创投资管理有限公司	境内非国有法人	5.59%	46,512,000.00	0.00	不适用				0.00
张祖蕾	境内自然人	2.53%	21,025,297.00	15,879,673.00	不适用				0.00
王成森	境内自然人	2.20%	18,300,062.00	0.00	不适用				0.00
沈欣欣	境内自然人	2.12%	17,675,335.00	0.00	不适用				0.00
南通蓉俊投资管理有限公司	境内非国有法人	1.97%	16,416,000.00	0.00	不适用				0.00
南通苏	境内非	0.96%	7,977,457.00	0.00	不适用				0.00

通集成电路重大产业项目投资基金合伙企业（有限合伙）	国有法人					
中国农业银行股份有限公司—中证500交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.89%	7,412,372.00	0.00	不适用	0.00
南通投资管理有限公司	国有法人	0.88%	7,326,236.00	0.00	不适用	0.00
上述股东关联关系或一致行动的说明	江苏捷捷投资有限公司、南通蓉俊投资管理有限公司与黄善兵为一致行动人，南通中创投资管理有限公司与张祖蕾为一致行动人。					

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

适用 不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

适用 不适用

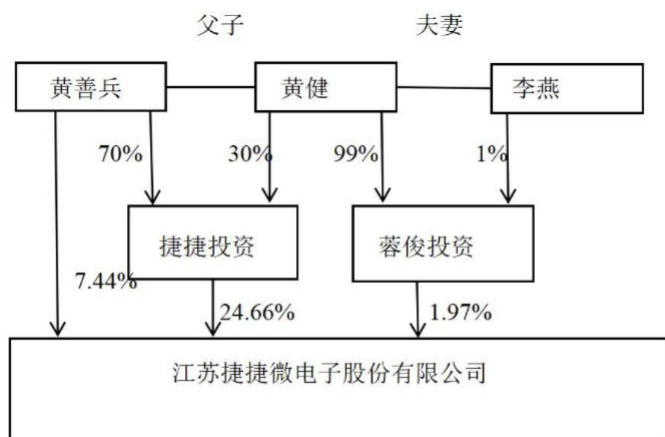
公司是否具有表决权差异安排

适用 不适用

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3) 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

适用 不适用

三、重要事项

江苏捷捷微电子股份有限公司于 2025 年 3 月 28 日召开第五届董事会第二十次会议、第五届监事会第十六次会议，审议通过《关于全资子公司之间吸收合并的议案》，同意由全资子公司捷捷微电（南通）科技有限公司吸收合并全资子公司捷捷微电（南通）微电子有限公司，本次吸收合并完成后，捷捷微电（南通）微电子有限公司全部资产、债权债务、业务、人员和相关资质等均由捷捷微电（南通）科技有限公司承继。吸收合并完成后于 2025 年 6 月 25 日取得最新捷捷微电（南通）科技有限公司的营业执照。具体内容详见公司于 2025 年 3 月 29 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于全资子公司之间吸收合并的公告》（公告编号：2025-016）及 2025 年 6 月 27 日披露的《关于全资子公司之间吸收合并完成的公告》（公告编号：2025-042）。